

2020-2026年中国聚酰亚胺树脂PI行业市场供需态势及竞争策略研究报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2020-2026年中国聚酰亚胺树脂PI行业市场供需态势及竞争策略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/202001/830562.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

PI聚酰亚胺塑料适用于耐高温自润滑轴承，压缩机活塞环，密封圈，烟草机械配件，打印机自动化配件，夹爪，垫片，套管等领域。

特性：

1、力学性能，耐疲劳性好，有良好自润滑性；均苯型聚酰亚胺薄膜的拉伸强度可达170MPa，联苯型可达400MPa

2、耐磨耗性，摩擦系数小且不受湿、温度的影响，冲击强度高，但对缺口敏感。

3、耐热性优异，可在-260（不会脆裂）~330oC长期使用，热变型温度高达343oC。

4、耐辐射性好，不冷流，不开裂，电绝缘性优异，阻燃。

5、收缩率、线膨胀系数小，尺寸稳定性好，吸水率低。

6、化学稳定性好，耐臭氧，耐细菌侵蚀，耐溶性好，但易受碱、吡啶等侵蚀。

智研咨询发布的《2020-2026年中国聚酰亚胺树脂PI行业市场供需态势及竞争策略研究报告》共六章。首先介绍了聚酰亚胺树脂PI相关概念及发展环境，接着分析了中国聚酰亚胺树脂PI规模及消费需求，然后对中国聚酰亚胺树脂PI市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国聚酰亚胺树脂PI面临的机遇及发展前景。您若想对中国聚酰亚胺树脂PI有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章我国聚酰亚胺树脂产品概述

1.1发展历程

1.2分类

1.2.1热塑性聚酰亚胺

1.2.2热固性聚酰亚胺

1.3聚酰亚胺树脂的合成方法

1.3.1主要四类聚酰亚胺树脂合成方法工艺特点

1.3.2世界及我国聚酰亚胺树脂的生产现状

第二章我国聚酰亚胺薄膜应用研究

2.1聚酰亚胺薄膜

2.2电子产品用聚酰亚胺薄膜的生产过程

2.2.1流涎法

2.2.2流涎-双向拉伸法

2.3聚酰亚胺材料及其薄膜的特性

2.4挠性覆铜板对聚酰亚胺薄膜的性能要求及主要品种

2.4.1挠性覆铜板对聚酰亚胺薄膜的性能要求

2.4.2挠性覆铜板用聚酰亚胺薄膜的主要规格及品种

2.5近年挠性覆铜板用聚酰亚胺薄膜技术性能方面的发展

第三章我国电子级聚酰亚胺薄膜市场发展研究

3.1在半导体及微电子工业领域中的应用

3.2在电子标签领域中的应用

3.3在挠性印制电路板领域中的应用

3.3.1聚酰亚胺薄膜在挠性覆铜板制造中的应用

3.3.2世界市场挠性覆铜板用PI薄膜的市场需求情况

第四章我国挠性覆铜板市场运营研究

4.1挠性覆铜板的品种及其特性

4.2主要挠性覆铜板品种的生产工艺流程

4.3世界挠性覆铜板市场需求及产业发展的情况

4.3.1世界挠性覆铜板市场——挠性印制电路板的需求情况

4.3.2世界挠性覆铜板生产情况

4.3.3世界挠性覆铜板的主要生产厂家

4.3.4日本挠性覆铜板业对PI薄膜的需求情况

4.4国内挠性覆铜板市场需求及产业发展的情况

4.4.1我国挠性覆铜板市场需求情况

4.4.2我国挠性覆铜板生产情况

4.4.3国内主要FCCL生产厂家现况

4.4.4我国FCCL业技术的现状

第五章国外主要发展概述

5.1世界电子级聚酰亚胺薄膜的生产现状及发展预测

5.2DuPont公司

5.2.1公司概况

5.2.2产品情况

5.3东丽.杜邦公司

5.3.1公司概况

5.3.2产品情况

5.4钟渊化学工业公司

5.4.1公司概况

5.4.2Apical的生产情况

5.4.3产品情况

5.5宇部兴产公司

5.5.1公司概况

5.5.2Upilex薄膜的生产情况

5.5.3产品情况

5.6韩国SKC公司

5.6.1公司概况

5.6.2SCK薄膜的生产及其市场情况

5.6.3产品情况

5.7台湾达迈科技公司

5.7.1公司概况

5.7.2产品及其市场情况

第六章我国国内电子级聚酰亚胺薄膜市场研究（ZY KT）

6.1挠性覆铜板用PI薄膜市场

6.2我国PI薄膜的研发生产概况

6.2.1聚酰亚胺研究工作的开展情况

6.2.2我国FCCL用PI膜国内生产情况

6.3我国主要PI薄膜生产厂家情况

6.3.1江苏亚宝绝缘材料有限公司

6.3.2无锡高拓聚合物材料有限公司

6.3.3溧阳华晶电子材料有限公司

6.3.4天津市天缘电工材料有限责任公司

6.3.5杭州泰达实业有限公司

6.3.6江苏贝昇新材料科技有限公司

6.3.7山东万达集团微电子材料有限公司

6.4我国产业竞争力（ZY KT）

图表目录：

图表1：聚酰亚胺化学结构通式

图表2：Regulus结构式

图表3：具有代表性PI（Kapton）的化学反应式及其分子结构

图表4：聚酰亚胺薄膜产品的外形

图表5：流延法生产PI膜的工艺流程

图表6：双轴定向法工艺流程图

图表7：理想的挠性覆铜板用聚酰亚胺薄膜的性能指标

图表8：挠性覆铜板制造常用聚酰亚胺薄膜主要性能

图表9：各类PI膜特性对比

图表10：世界主要PI薄膜生产厂家在FCCL用PI薄膜产品品种、特性方面的发展况

图表11：世界主要PI薄膜生产厂家典型FCCL用PI薄膜产品的性能比较

图表12：美国Kapton薄膜与国产PI薄膜的性能比较

图表13：挠性印制电路板的用途

图表14：挠性印制电路板产品实例

图表15：2015-2019年世界市场挠性覆铜板用PI薄膜的市场需求

图表16：FCCL典型产品的外形

图表17：两大类挠性覆铜板的结构

图表18：两类挠性覆铜板的特性及应用比较

图表19：三类二层型FCCL的工艺加工特点及剖面结构图

图表20：采用卷状涂布工艺法制3L-FCCL的工艺流程图

图表21：采用卷状涂布工艺法制3L-FCCL的工艺流程图

图表22：涂布法二层型FCCL的产品构成（双面覆铜箔的2L-FCCL）

图表23：涂布法二层型FCCL的生产过程示意图

图表24：三层型聚酰亚胺基膜FCCL和聚酯基膜FCCL的主要性能

图表25：二层型聚酰亚胺基膜FCCL（涂布法）的主要性能

图表26：2015-2019年世界FPC产值统计

图表27：2015-2019年世界FCCL产量

图表28：世界FCCL（包括2L-FCCL和3L-FCCL）生产格局

图表29：2015-2019年我国挠性覆铜板市场需求分析

图表30：2015-2019年我国挠性覆铜板市场生产分析

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202001/830562.html>